

	HoVB 外折脚系列规格书	系列号	HoLRS
		修订日期	2023-04-08
		版本号	Ho-B1

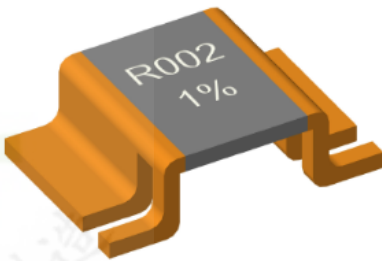
规格书 Specification

制造商:深圳市毫欧电子有限公司

适用：本规格书适用于深圳市毫欧电子有限公司裸露合金电阻 HoVB 外折脚系列产品选型。

■ 产品特点Features:

- 电子束焊工艺，焊接性能良好，易于焊接
- 高可靠性，高过载能力，产品精度高
- 使用温度范围较宽无感型设计，电感小于 10 纳
- 亨电阻温度系数TCR (2 5~50ppm/℃)
- 产品符合 ROHS 要求
- 产品符合 AEC-Q200 要求



■ 产品名称Product Name

裸露合金电阻

■ 产品型号Product number

Ho	VB	5W	3mR	1%
↓	↓	↓	↓	↓
制造商	产品系列	额定功率(W)	阻值 (mR)	精度 (%)
毫欧电子	裸露合金	5	0.2~5	D=±0.5% F=±1% J=±5%



国家高新技术企业



IATF16949



ISO9001



TUV SUD



SGS

AEC-Q200



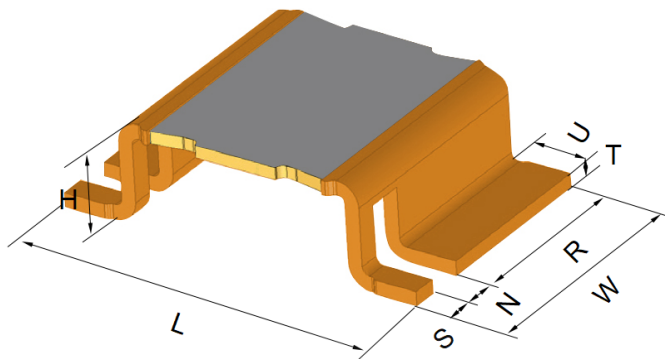
地址：深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼



HoVB 外折脚系列规格书

系列号	HoLRS
修订日期	2023-04-08
版本号	Ho-B1

■ 产品尺寸 Product Size (Unit:mm)



Type	W	L	H	R	N	S	U	T
HoVB-0.2mR	6.7±0.5	10.1±0.5	3.6±0.5	5.0±0.2	1±0.15	0.7±0.1	2.0±0.2	0.6±0.15
HoVB-0.3mR	6.7±0.5	10.1±0.5	3.6±0.5	5.0±0.2	1±0.15	0.7±0.1	2.0±0.2	0.6±0.15
HoVB-0.5mR	6.7±0.5	10.1±0.5	3.3±0.5	5.0±0.2	1±0.15	0.7±0.1	2.0±0.2	0.6±0.15
HoVB-0.7mR	6.7±0.5	10.1±0.5	3.0±0.5	5.0±0.2	1±0.15	0.7±0.1	2.0±0.2	0.4±0.15
HoVB-1mR	6.7±0.5	10.1±0.5	3.0±0.5	5.0±0.2	1±0.15	0.7±0.1	2.0±0.2	0.4±0.15
HoVB-2mR	6.7±0.5	10.1±0.5	3.0±0.5	5.0±0.2	1±0.15	0.7±0.1	2.0±0.2	0.4±0.15
HoVB-3mR	6.7±0.5	10.1±0.5	3.0±0.5	5.0±0.2	1±0.15	0.7±0.1	2.0±0.2	0.4±0.15
HoVB-4mR	6.7±0.5	10.1±0.5	3.0±0.5	5.0±0.2	1±0.15	0.7±0.1	2.0±0.2	0.4±0.15
HoVB-5mR	6.7±0.5	10.1±0.5	3.0±0.5	5.0±0.2	1±0.15	0.7±0.1	2.0±0.2	0.4±0.15

■ 电气参数 Electrical parameter

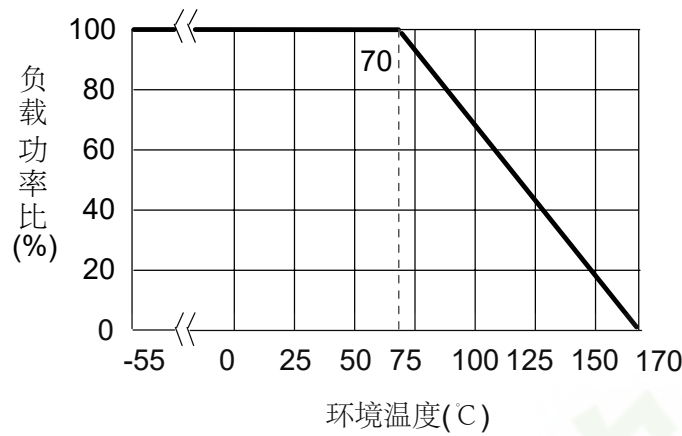
电阻值 Resistance values (mR)	0.2 to 5
额定功率 Rated power (W)	5
最大额定电流 Max.Rated Current 158A	158.11
准确度 Accuracy (%)	0.5 to 5
电阻温度系数 TCR (ppm / °C)	25~50, 小于25ppm可定制
工作温度范围 Operating Temperature Range	-50℃~+170℃
电感值 Inductance (nH)	<10

地址：深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼

	HoVB 外折脚系列规格书	系列号	HoLRS
		修订日期	2023-04-08
		版本号	Ho-B1

■ 功率降额曲线 Power curve

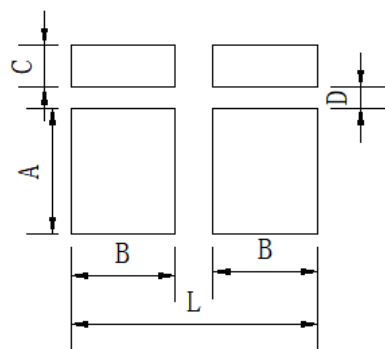
操作温度范围 - 55 ~ +170 °C 电阻温度达到 70°C 时降功率 示意图



■ 性能测试 Performance Testing

Parameters	Test conditions	Specified values
Temperature Cycling	2000 cycles (-55°C to +150°C)	±0.5 %
Low Temperature Storage and Operation	-65°C for 250 h	±0.1 %
Resistance to Soldering Heat	260°C for 10 sec/8h steam aging	n.a.
Moisture Resistance	MIL-STD-202 method 106	±0.1 %
Mechanical Shock	100 g, 6 ms half sine	±0.2 %
Vibration, High Frequency	10 g, 10-2000 Hz, 24 h each axis	±0.2 %
Operational Life	2000 h, T _K max at rated power	±1.0 %, T _K = 130°C
High Temperature Exposure	2000 h/170°C	±1.0 % (in covered condition)*
Bias Humidity	+85°C, 85 r.F., 1000 h	±0.5 %

■ 建议焊盘尺寸 Recommended Solder Pad Dimension



Solder pad type	L	A	B	C	D
HoVB	10.6	5.6	2.5	0.9	0.8

地址：深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼



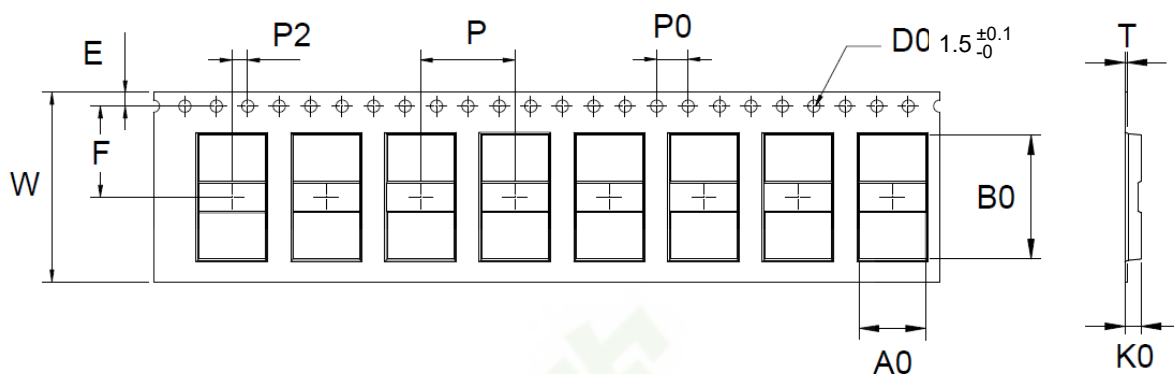
HoVB 外折脚系列规格书

系列号	HoLRS
修订日期	2023-04-08
版本号	Ho-B1

■ 包装方式Packing

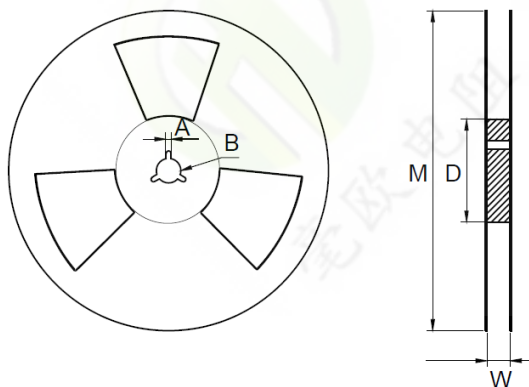
编带盘装：1500pcs/盘

■ 载带尺寸Ribbon size (Unit:mm)



A0	B0	W	F	E	T	K0	P	P0	P2
6.85±0.1	10.5±0.1	16±0.3	5.5±0.1	1.75±0.1	0.3±0.05	4.2±0.1	13±0.1	4±0.1	2.0± 0.1

■ 卷轴规格 Reel Specification (Unit:mm)



W	M	A	B	D	Packaging Quantity
16+0.5	350±1	2.3±1	13.2±1	100±2	1500PCS

地址：深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼

修改履历表：

序号	修改内容	修改日期	修改原因	版本	更改人
1	增加焊盘尺寸推荐及包装尺寸图	2022-06-10	内部增加	A0升级B0	黄忠亮
2	增加5mR产品	2023-04-08	产品升级	B0升级B1	黄永康

地址：深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼